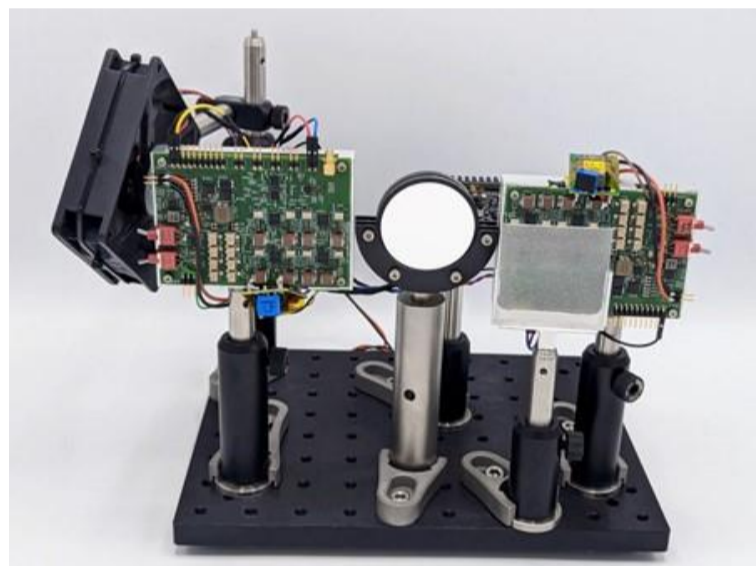


捷普携手艾迈斯欧司朗和光程研创 共创 3D 摄像机新时代

新一代 SWIR 3D 摄像机即将来临!

近日，位于德国耶拿的知名光学设计中心正展示着新一代的 3D 摄像机原型，该产品是一款可在 1130nm 波段的短波红外光线 (SWIR) 运作的 3D 摄像机，结合了捷普、艾迈斯欧司朗与光程研创各自的 3D 感测架构设计、半导体激光器和锗硅 (germanium silicon; GeSi) 传感器数组之专有技术，可在室内与户外环境中无缝运行，范围可达 20 米。



捷普在 1130nm 波段的新款 SWIR 3D 摄像机原型展示图

自动化的高速发展正驱动着机器人和移动式自动化平台的性能优化。据推算，到 2029 年，工业机器人市场将实现超过 11% 的年复合成长率，达到 350 亿美金。而那些通过创新摄像机获取的 3D 感测数据将会极大地提升自动化功能，包括：障碍物辨识、防撞、定位定向与路线规划等，这些功能皆为自主平台的关键应用。

“长期以来，在 3D 感测解决方案中，物料平台的操作需避免阳光的干扰已成为行业共识，而新款 SWIR 摄像机则为 3D 感测提供了一个不受限的环境，也就是阳光不再影响自主平台的效能。新一代 3D 摄像机不但重新定义了中距离范围内对光耐受性的产业标准，亦将开创一个能在所有光照环境中运作的传感器新典范。”

——捷普光学部业务发展资深总监 Ian Blasch

“我们很兴奋能携手捷普，共同将下一代 3D 感测与机器视觉解决方案落为现实。1130nm 是艾迈斯欧司朗首款 SWIR VCSEL 光学激光技术，可强化人眼安全性、在强烈阳光环境下，提供的优异效能与皮肤侦测，从而避免机器人与人的触碰。”

——艾迈斯欧司朗资深副总裁暨视觉与感测事业处总经理 Joerg Strauss 博士

“携手捷普、艾迈斯欧司朗共同合作发展第一款无动件中距离范围的 SWIR 3D 摄像机，我们倍感幸运。SWIR 3D 摄像机搭载了类似近红外光 (NIR) 的类组件（即基于 CMOS 制程之传感器和 VSCSEL 技术），借助了 CMOS 制程的 SWIR 2D/3D 双模成像技术的重要突破来解决业界痛点，同时也推动了 SWIR 光学感测产品全面普及。”

——光程研创技术平台开发副总经理叶智伟 (Stanley Yeh) 博士

多年来，捷普光学部一直是业界公认的先进光学设计、工业化与制造服务供应商。捷普光学部在全球四个据点拥有超过 170 名员工，旗下的光学设计师、工程师、研究员都擅长为 3D 感测、扩增与虚拟现实、运动相机、车用、工业和健康照护市场的客户解决复杂的光学问题。此外，捷普在产品设计与程序发展、测试、内部主动对准、供应链管理与制造等专业实力，亦能助力全球客户加速创新成果的推进与落地。